



ものづくりの面（立場）から見た 本学会の役割

中祖 昭士*

今年度、本学会の技術運営委員会の委員長をおおせつかりました。ものづくりの側面から本学会の役割を考えてみます。エレクトロニクス技術はトランジスタが発明されてからわずか60年で地球規模のデジタル情報化社会を創りあげるところまで大きく発展してきました。こうした中でエレクトロニクス実装技術も大きくかつ多様に発展してきました。実装技術の全体像を把握することが困難なほどの多様な姿になってきました。実装技術の世界で活躍している研究者、技術者、技術経営者などの多くの人々にとって実装技術の全体像の把握が困難になればなるほど実装技術の現状および将来動向への関心が強まっていると感じています。

エレクトロニクス実装学会は情報開示の場であり同時に情報入手の場でもあります。一方、インターネットが進歩し各自のPCから低コストで不特定多数向けに情報を発信することができ、また機械検索によって豊富な技術情報を容易に入手できるようになりました。情報活用の第一段階ではこのようなインターネットによる情報発信と機械検索が大きな役割を果たしてくれます。しかし一歩踏み込んだ共同研究や新規な技術融合を進めるためにはリアルな人間同士の交流が必要です。本学会に実装技術に関する最新情報が多数集まり、本学会の利用者に最新の实装技術情報が伝えられ、本学会の場を通してリアルな人間同士の交流が深まるのが本学会の最大の役割であり、本学会が発展するための必須の条件と強く感じています。

個別的な問題ですがもう1つ重要になってきていると思う問題があります。携帯用途を中心とした電子機器の高機能化、高密度化、軽量・薄型化が急速に進歩してきました。実装技術の進歩の賜物です。一方この変化の中で信頼性確保に関する技術が立ち遅れているのではないかと心配します。電子機器の信頼性確保も実装技術の重要な領域です。信頼性の良し悪しは実装技術のレベルを示す指標です。日本発のエレクトロニクス製品が世界に受け入れられてきたのは高機能化、高密度化、軽量・薄型化の点において優れていたことはもとより高信頼性という価値があったからだと思います。本学会が中心になって地道な信頼性の高い実装技術開発を活発化していくとともに、高機能、高密度、軽量・薄型化と信頼性が両立できる新規なブレークスルー技術の開発に力を入れていく必要があります。